

有研半导体硅材料股份公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会将2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金47,319.09万元，本年度实际使用募集资金52,737.27万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为70,856.92万元（包

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额为15,856.92万元，与募集资金余额相差55,000.00万元均为未到期的现金管理余额。

募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	259,585,963.98
减：本年度投入募集资金总额	527,372,766.60
减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	-2,955,006.37
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	-400,000,000.00
减：支付的其他发行费用	-
加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	23,400,991.29
募集资金专项账户期末余额	158,569,195.04

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	4,315.16	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.15	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	7,394.67	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.32	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	3,869.62	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为本公司及股东获取更多回报，2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	30,000.00	2024.12.31-2025.03.26	否
中信银行北京分行	结构性存款	浮动收益	15,000.00	2024.12.28-2025.03.31	否
浦发银行北京分行	结构性存款	浮动收益	10,000.00	2024.12.31-2025.03.26	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月27日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》，拟用于永久补充流动资金的金额为19,000.00万元，占超募资金总额的比例为28.62%。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。公司已于2024年7月4日将19,000万元超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于股份回购

公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含）。

截至2024年12月31日，公司本次股份回购计划已实施完毕。公司累计回购股份3,555,336股，占公司总股本的比例为0.28%，支付总金额为35,931,966.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见2024年2月21日和2024年5月6日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）和《有研半导体硅材料股份公

司关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-026）。

2、部分募投项目延期

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体详见2024年4月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2024年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》编制,并在所有重大方面如实反映了有研硅2024年度募集资金存放与实际使用情况。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2025)第0111号)。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:截至2024年12月31日,除已披露内容外,公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,保荐机构对有研硅2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年3月31日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(注 1)				1,663,967,265.37		本年度投入募集资金总额				527,372,766.60		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,000,563,619.63		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)(注 3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充研发与运营资金	无	257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	66,116,556.21	180,980,031.19	-76,848,068.81	70.19	不适用	不适用	不适用	否
集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	无	384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00	144,689,213.68	253,551,681.92	-131,272,618.08	65.89	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	无	357,347,600.00	357,347,600.00	357,347,600.00	90,631,309.12	145,096,218.93	-212,251,381.07	40.60	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	301,437,079.01	579,627,932.04	-420,372,067.96	57.96	——	——	——	——
超募资金永久补流(注 2)	无	不适用	385,000,000.00	385,000,000.00	190,000,000.00	385,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
股份回购(注 2)	无	不适用	35,935,687.59	35,935,687.59	35,935,687.59	35,935,687.59	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	1,000,000,000.00	1,420,935,687.59	1,420,935,687.59	527,372,766.60	1,000,563,619.63	-420,372,067.96	70.42	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						详见附注 4						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期内,公司未发生此情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内,公司未发生此情况						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理情况						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						详见三、(八)募集资金使用的其他情况						

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金总额 663,967,265.37 元，其中 385,000,000.00 元用于永久补流，35,935,687.59 元（含印花税、交易佣金等交易费用）用于股份回购。

注 3：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 4：未达到计划进度原因主要基于以下因素：第一，受市场需求变动的影响，公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化，使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异。第二，本着控制成本、提高募集资金使用效率的原则，公司适当调整了投资节奏。“集成电路用 8 英寸硅片扩产项目”分两个阶段执行，目前第一阶段 5 万片/月的产能已经建设完毕，公司 8 寸硅片产能已达到 18 万片/月，且保持了较高的产能利用率；同时，第二阶段建设已经启动。“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响，开工较预期延迟。